

嵌入式人工智能 (AI) 系统



拼接全景
摄像机领域

人工智能
设备领域

深度学习
算法领域

机器人
开发领域

无人机
开发领域

超高清视频
技术领域

基于Hisilicon Hi3559A 2*A73+3*A53+1*M7+2*G71+4*DSP+2*NNIE多核异构处理器，板载4GB DDR4内存，16GB EMMC Flash，支持1x TF卡槽，独立DSP和GPU，支持8K@30fps+1080P@30fps或4K@120+1080P30，H.265编码，支持2*4Kp60，4*4Kp30或8*1080P30视频录制，双核NNIE神经网络计算引擎，支持深度学习神经网络加速，算力可达4T，支持多路Sensor 2chn/4chn/6chn全景硬件拼接，支持HDR10/14bit ISP Pipeline，最大支持36M像素传感器输入，支持PCI-E 2.0 + USB3.0高速存储，支持4K HDMI输出。

产品基于智能海思芯片组平台，具有高品质超高清视频编解码能力、接口丰富、扩展性强等特点。可应用于拼接全景摄像机领域、人工智能设备领域、深度学习算法领域、机器人开发应用领域、无人机开发领域以及超高清视频技术领域。

BIS-6545

基于Hisilicon Hi3559A处理器 嵌入式AI系统



基于Hisilicon Hi3559A处理器的嵌入式AI系统

产品特点：

- 基于Hisilicon Hi3559A 2*A73+3*A53+1*M7+2*G71+4*DSP+2*NNIE多核异构处理器
- 板载4GB DDR4内存，16GB EMMC Flash，支持1x TF卡槽
- 独立DSP和GPU，支持8K@30fps+1080P@30fps或4K@120+1080P30，H.265编码
- 支持2*4Kp60,4*4Kp30或8*1080P30视频录制
- 双核NNIE神经网络计算引擎，支持深度学习神经网络加速，算力可达4T
- 支持多路Sensor 2chn/4chn/6chn全景硬件拼接
- HDR10/14bit ISP Pipeline
- 最大支持36M像素传感器输入
- 支持PCI-E 2.0 + USB3.0高速存储，支持4K HDMI输出

Model	BIS-6545
Colour	黑色
Material	优质碳素高强度结构钢箱体
Dimensions	222mmx 150mmx 46.5mm(WxDxH)
Mounting	桌面或壁挂安装
Motherboard	EMB-7540
Platform	Hisilicon ARM平台
CPU	HiSilicon Hi3559A 2*A73+3*A53+1*M7+2*G71+4*DSP+2*NNIE多核异构处理器
Memory	板载4GB DDR4 内存
Storage	板载16GB iNAND Flash，1x TF卡槽
GPU	Mali 2*G71@900MHz GPU
Display	1x HDMI
Ethernet	1x LAN，10/100/1000Mbps
USB	1x USB3.0
COM	1x Rs232
Audio	支持3.5mm 4节耳机孔
Other I/O	MUX接口 (支持1x Rs234，1x Rs485，2x DI，DO)
RTC	支持
Watchdog	支持
System control	1x RST BUTTON
LED	电源指示灯
Cooling system	无风扇散热
Power supply	DC +12V电源适配器
Temperature	工作温度：0°C ~ 60°C；存储温度：-40°C ~ 85°C
Humidity	5% ~ 95%相对湿度，无冷凝
Vibration during Operation	0.5g rms/5~500Hz/random工作状态下
ROHS	Yes
MTBF	≥60,000小时
OS	Linux

产品接口图片：



尺寸图：

